財團法人工業技術研究院　函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：林秀姿
電話：03-5916636
傳真：03-5820466
E-mail：iris.lin@itri.org.tw

107000716418

241 新北市三重區重新路五段 609 巷 6 號 3 樓之 3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會 收文 107.05.03 檔號：107302

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 107 年 05 月 02 日
發文字號：工研轉字第 1070007164 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：為本院「光電與資通訊等相關專利讓與案」公開招標事，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理光電與資通訊等相關專利 86 案 143 件之讓與公開招標活動(詳如附件)。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

（一）工研院研發成果公告網站（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）

（二）台灣技術交易資訊網（https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx）。

三、本案截標日為 107 年 5 月 24 日，開標日為 107 年 5 月 25 日。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：107 年 5 月 17 日下午 15 時 30 分至 16

時 30 分。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 108 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 107 年 5 月 14 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「光電與資通訊等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。），聯絡人將於 107 年 5 月 16 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：(03) 591-6636

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

公司設立登記表影本)、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「光電與資通訊等相關專利讓與案投標」，於截標日 107 年 5 月 24 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 林小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「專利標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 107 年 5 月 25 日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

工業技術研究院
光電與資通訊等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含光電與資通訊等相關專利 86 案 143 件。以下簡稱「讓與標的」。

「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網（https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx）、及工研院研發成果公告網站（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）107 年 5 月 17 日 15 時 30 分整於工研院中興院區 51 館 108 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 107 年 5 月 14 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「光電與資通訊等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 107 年 5 月 16 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 107 年 5 月 24 日下午 5 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或

授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起30個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用

性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「專利標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「專利標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「專利標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「專利標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「專利標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「專利標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「專利標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院、主管機關及立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：

（1）得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

（2）得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

（3）得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

（4）得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13.得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

(1)得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他

人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

(3)為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15.得標廠商應使所有「後手」遵守九、契約事項第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「專利標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：(03) 591-6636，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

附件：專利清單

案次	件次	領域第一階	領域第二階	件編號	專利名稱	國家	申請號	專利證號	狀態	專利起期	專利迄期	非專屬授權中	曾非專屬授權	委辦單位
1	1	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P08930004TW	光學讀寫頭	台灣	93120006	I254293	獲證	20060501	20240701	V		經濟部技術處
	2	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P08930004CN	一種光學讀寫頭	中國	200410071036.5	ZL200410071036.5	獲證	20080109	20240726			經濟部技術處
	3	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P08930004USC1	光學讀寫頭	美國	12/149,235	7,486,592	獲證	20090203	20250308	V		經濟部技術處
2	4	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P08930067TW	物鏡致動器	台灣	93141619	I275086	獲證	20070301	20241230	V		工研院
	5	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P08930067US	物鏡致動器	美國	11/311,539	7,542,384	獲證	20090602	20270714	V		工研院
3	6	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P51950160TW	光學讀取頭及其電磁致動裝置	台灣	95149334	I336073	獲證	20110111	20261226	V		經濟部技術處
	7	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P51950160US	光學讀取頭及其電磁致動裝置	美國	11/727,821	7,672,198	獲證	20100302	20280615	V		經濟部技術處
4		電子與光電	可讀寫型光學頭技術	084880030US	緊湊式光學讀寫頭	美國	09/376,666	6,341,116	獲證	20020122	20190815			經濟部技術處
5	9	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	084880073US	單物鏡光學讀寫頭	美國	09/417,952	6,304,541	獲證	20011016	20191012			經濟部技術處
6	10	電子與光電	可讀寫型光學頭技術	P08910066US	近場光學頭物鏡	美國	10/618,680	6,844,983	獲證	20050118	20230804			經濟部技術處
7	23	電子與光電	光資訊技術	084880029US	可讀寫之光學頭	美國	09/376,669	6,343,059	獲證	20020129	20190815			經濟部技術處
8	11	電子與光電	光機機構技術	084880020TW	多光源之光學讀寫頭	台灣	88103993	126521	獲證	20010121	20190315	V	V	經濟部技術處
	12	電子與光電	光機機構技術	084880020US	多光源之光學讀寫頭	美國	09/304,468	6,324,150	獲證	20011127	20190502	V	V	經濟部技術處
9	13	電子與光電	光機機構技術	084900001TW	光碟機控制機構	台灣	90112341	175380	獲證	20030321	20210522	V		經濟部技術處
	14	電子與光電	光機機構技術	084900001US	光碟機控制機構	美國	09/930,748	6,665,253	獲證	20031216	20220712	V		經濟部技術處
10	15	電子與光電	光機機構技術	084870049US	雙焦距光學讀取頭	美國	09/262,962	6,236,633	獲證	20010522	20190304		V	工研院
	16	電子與光電	光機機構技術	084870049USD	雙焦距光學讀取頭	美國	09/799,382	6,430,138	獲證	20020806	20210227		V	工研院
11	17	電子與光電	光機機構技術	084870071US	碟片承載裝置	美國	09/299,958	6,259,667	獲證	20010710	20190426			經濟部技術處
12	18	電子與光電	光機機構技術	084880040US	碟片夾持機構	美國	09/360,845	6,363,048	獲證	20020326	20190723			經濟部技術處
13	19	電子與光電	碟片夾持和承載機構	084870050US	磁浮式自動升降碟片壓覆具	美國	09/263,767	6,292,456	獲證	20010918	20190304			經濟部技術處
14	20	電子與光電	碟片夾持和承載機構	084890017US	磁鐵吸附式自動升降碟片壓覆具	美國	09/482,424	6,316,854	獲證	20011113	20200112		V	經濟部技術處
15	21	電子與光電	光儲存材料.製造技術	084880033US	高光學對比之可擦拭光學記錄材料及其記錄媒體	美國	09/333,530	6,278,684	獲證	20010821	20190615		V	經濟部技術處
16	22	電子與光電	檔案格式技術	084880068US	可擦除式光碟片之動態缺陷管理方法	美國	09/434,863	6,415,400	獲證	20020702	20191104		V	經濟部技術處
17	24	電子與光電	投影光學元件	P51960083TW	影像螢幕	台灣	96141844	I364622	獲證	20120521	20271105			經濟部技術處
	25	電子與光電	投影光學元件	P51960083CN	圖像螢幕	中國	200710196256.4	ZL200710196256.4	獲證	20101229	20271129			經濟部技術處
	26	電子與光電	投影光學元件	P51960083US	影像螢幕	美國	12/024,120	8,009,357	獲證	20110830	20281210			經濟部技術處
18	27	電子與光電	投影光學元件	084870065US	廣角變焦鏡頭	美國	09/173,488	6,011,656	獲證	20000104	20181013		V	經濟部技術處
19	28	電子與光電	光學技術(含鏡片材料)	P51980149TW	曝光系統及其調校方法	台灣	99119091	I416275	獲證	20131121	20300610			經濟部技術處
20	29	電子與光電	光學技術(含鏡片材料)	P51990040TW	影像處理方法及其系統	台灣	99128473	I424376	獲證	20140121	20300824			經濟部技術處
	30	電子與光電	光學技術(含鏡片材料)	P51990040US	影像處理方法及其系統	美國	12/964,022	8,553,986	獲證	20131008	20310629			經濟部技術處
21	31	電子與光電	光學技術(含鏡片材料)	P51980120CN	照明裝置及其光學元件模塊	中國	201010002876.1	ZL201010002876.1	獲證	20130123	20300120			經濟部技術處
22	32	電子與光電	鏡片技術	P28030004US	環境調光裝置、系統與方法	美國	14/222,693	9,423,665	獲證	20160823	20340724			經濟部技術處
23	33	電子與光電	鏡片技術	P51970102CN	自動對焦鏡頭模塊	中國	200910165301.9	ZL200910165301.9	獲證	20140409	20290804			工研院
24	34	電子與光電	投影光源	P08940032TW	偏極化發光元件	台灣	94132260	I261378	獲證	20060901	20250918			經濟部技術處
	35	電子與光電	投影光源	P08940032US	偏極化發光元件	美國	11/423,958	7,495,375	獲證	20090224	20270605			經濟部技術處
25	36	電子與光電	投影光源	P08940040US	照明裝置及運用此照明裝置之投影系統	美國	11/308,709	7,270,457	獲證	20070918	20260424	V		經濟部技術處
26	37	電子與光電	3D 影像與互動技術	P51980081TW	立體顯示器的像素資料轉換方法與裝置	台灣	98146178	I393430	獲證	20130411	20291230			經濟部技術處
	38	電子與光電	3D 影像與互動技術	P51980081US	立體顯示器的像素資料轉換方法與裝置	美國	12/861,838	8,508,581	獲證	20130813	20311202			經濟部技術處

27	39	電子與光電	電阻式隨機存取記憶體	P28000003TW	具二極體整流能力的電阻式記憶體	台灣	100124192	I501405	獲證	2015 0921	2031 0707			工研院
28	40	電子與光電	電阻式隨機存取記憶體	P28010001TW	電阻式記憶體結構、其操作方法及製作方法	台灣	101132176	I489461	獲證	2015 0621	2032 0903			工研院
	41	電子與光電	電阻式隨機存取記憶體	P28010001CN	電阻式存儲器結構、其操作方法及制作方法	中國	201210425540.5	ZL201210425540.5	獲證	2016 0629	2032 1030			工研院
	42	電子與光電	電阻式隨機存取記憶體	P28010001US	電阻式記憶體結構、其操作方法及製作方法	美國	13/690,250	9,159,916	獲證	2015 1013	2033 0801			工研院
29	43	電子與光電	矽基半導體技術	P28010006TW	金氧半場效電晶體元件	台灣	101141197	I473267	獲證	2015 0211	2032 1105			工研院
	44	電子與光電	矽基半導體技術	P28010006US	金氧半場效電晶體元件	美國	13/914,640	9,018,638	獲證	2015 0428	2033 0628			工研院
30	45	電子與光電	IC 設計實現技術	P28990010TW	組合式數位輸出系統	台灣	100105715	I448071	獲證	2014 0801	2031 0221			工研院
	46	電子與光電	IC 設計實現技術	P28990010US	組合式數位輸出系統	美國	13/157,671	8,593,316	獲證	2013 1126	2032 0618			工研院
31	47	電子與光電	薄膜電晶體(TFT)元件與製程	P28000009TW	電晶體的操作方法	台灣	101100157	I458112	獲證	2014 1021	2032 0102			工研院
32	48	電子與光電	液晶顯示器(LCD)元件與製程	P51950169TW	液晶顯示模組	台灣	96104572	I352857	獲證	2011 1121	2027 0207			經濟部技術處
33	49	電子與光電	驅動電路與週邊系統	P51000079US	光源裝置及其驅動裝置	美國	13/335,978	8,836,233	獲證	2014 0916	2033 0403			經濟部技術處
34	50	電子與光電	其他	P28990005TW	在多碳粉之碳粉重疊光電成像裝置中穩定各種碳粉成份之電荷對質量比的方法和裝置	台灣	90108380	I256531	獲證	2006 0611	2021 0405			工研院
	51	電子與光電	其他	P28990005US	在多碳粉之碳粉重疊光電成像裝置中穩定各種碳粉成份之電荷對質量比的方法和裝置	美國	09/722,995	6,484,004	獲證	2002 1119	2020 1126			工研院
	52	電子與光電	其他	P28990005DE	在多碳粉之碳粉重疊光電成像裝置中穩定各種碳粉成份之電荷對質量比的方法和裝置	德國	EP01970102.8	EP1340127	獲證	2009 1125	2021 0927			工研院
35	53	電子與光電	其他	P28990006CN	交流電暈放電裝置	中國	00802279.8	ZL00802279.8	獲證	2009 0520	2020 1004			工研院
	54	電子與光電	其他	P28990006US	交流電暈放電裝置	美國	09/420,393	6,205,309	獲證	2001 0320	2019 1017			工研院
	55	電子與光電	其他	P28990006DE	交流電暈放電裝置	德國	EP00968718.7	EP1175643	獲證	2006 0705	2020 1004			工研院
36	56	電子與光電	其他	P28990008TW	使用活動卡匣提供成像裝置之簡化升級路徑的系統和方法	台灣	90108381	I88400	獲證	2003 1001	2021 0405			工研院
	57	電子與光電	其他	P28990008CN	給可移去處理盒的成像設備提供升級通道的系統及方法	中國	01141264.X	ZL01141264.X	獲證	2007 0207	2021 1010			工研院
	58	電子與光電	其他	P28990008US	使用活動卡匣提供成像裝置之簡化升級路徑的系統和方法	美國	09/717,325	6,535,704	獲證	2003 0318	2020 1119			工研院
37	59	資訊與通訊	網路應用安全	P28000007TW	驗證方法與系統	台灣	100128103	I430217	獲證	2014 0311	2031 0807			工研院
	60	資訊與通訊	網路應用安全	P28000007US	驗證方法與系統	美國	13/290,038	8,774,412	獲證	2014 0708	2031 1107			工研院
38	61	資訊與通訊	網路應用安全	P28010004TW	電子裝置之認證方法及密碼設定方法及認證系統	台灣	101130813	I476626	獲證	2015 0311	2032 0823			工研院
	62	資訊與通訊	網路應用安全	P28010004CN	電子裝置之認證方法及密碼設定方法及認證系統	中國	201210382410.8	ZL201210382410.8	獲證	2017 0517	2032 1010			工研院
	63	資訊與通訊	網路應用安全	P28010004US	電子裝置之認證方法及密碼設定方法及認證系統	美國	13/944,385	9,141,777	獲證	2015 0922	2033 1217			工研院
39	64	資訊與通訊	網路應用安全	P28010010TW	多點觸碰方法與裝置	台灣	102113985	I501101	獲證	2015 0921	2033 0418			工研院
	65	資訊與通訊	網路應用安全	P28010010CN	多點觸碰方法與裝置	中國	201310244560.7	ZL201310244560.7	獲證	2017 0912	2033 0618			工研院
	66	資訊與通訊	網路應用安全	P28010010US	多點觸碰方法與裝置	美國	14/081,855	9,336,376	獲證	2016 0510	2034 0828			工研院
40	67	資訊與通訊	網路通訊安全	P28020001TW	網路認證系統及其方法	台灣	102126129	I514189	獲證	2015 1221	2033 0721			工研院
	68	資訊與通訊	網路通訊安全	P28020001CN	網路認證系統及其方法	中國	201310547475.8		審查中					工研院
41	69	資訊與通訊	資訊安全	P28000005TW	應用圖形稽碼機制之認證方法與系統	台灣	100125063	I460606	獲證	2014 1111	2031 0714			工研院
	70	資訊與通訊	資訊安全	P28000005CN	應用驗證碼機制的認證方法與系統	中國	201110222808.0	ZL201110222808.0	獲證	2015 0513	2031 0731			工研院
	71	資訊與通訊	資訊安全	P28000005US	應用圖形稽碼機制之認證方法與系統	美國	13/230,924	8,607,331	獲證	2013 1210	2031 0912			工研院
42	72	資訊與通訊	射頻技術	P28990003TW	具光子能隙結構之矽基懸浮天線及其製造方法	台灣	99138398	I449255	獲證	2014 0811	2030 1107			工研院
	73	資訊與通訊	射頻技術	P28990003CN	具光子帶隙結構的矽基懸浮天線及其制造方法	中國	201010617482.7	ZL201010617482.7	獲證	2014 0917	2030 1230			工研院
	74	資訊與通訊	射頻技術	P28990003US	具光子能隙結構之矽基懸浮天線及其製造方法	美國	13/034,025	8,963,779	獲證	2015 0224	2033 0817			工研院
43	75	資訊與通訊	射頻技術	P52980011TW	利用通道編碼演算法用於排序及解排序之網路	台灣	96114905	I376885	獲證	2012 1111	2027 0426			工研院
	76	資訊與通訊	射頻技術	P52980011CN	利用通道編碼算法用於排列和解排列的網路	中國	200710097650.2	ZL200710097650.2	獲證	2010 0908	2027 0426			工研院
	77	資訊與通訊	射頻技術	P52980011US	利用通道編碼演算法用於排序及解排序之網路	美國	11/414,433	7,856,579	獲證	2010 1221	2029 0113			工研院
44	78	資訊與通訊	射頻技術	P28000008CN	小型寬帶垂直極化全向天線	中國	200410084304.7	ZL200410084304.7	獲證	2007 0718	2024 1117	V		工研院

45	79	資訊與通訊	無線通訊系統	P52980010TW	一跨序列排序渦輪碼系統及其作動方法	台灣	95124578	I345386	獲證	2011 0711	2026 0705			工研院
	80	資訊與通訊	無線通訊系統	P52980010CN	一跨序列排序渦輪碼系統和其操作方法	中國	200610098458.0	ZL200610098458.0	獲證	2009 0527	2026 0706			工研院
	81	資訊與通訊	無線通訊系統	P52980010USD1	一跨序列排序渦輪碼系統及其作動方法	美國	12/434,601	8,769,371	獲證	2014 0701	2028 0503			工研院
46	82	資訊與通訊	無線通訊技術	P28010007CN	單級降壓轉換電路	中國	201210443831.7	ZL201210443831.7	獲證	2016 1221	2032 1107			工研院
	83	資訊與通訊	無線通訊技術	P28010007US	單級降壓轉換電路	美國	13/777,996	9,093,898	獲證	2015 0728	2033 1124			工研院
47	84	資訊與通訊	數位視/音訊處理	P51970140TW	移動向量之編碼模式選擇方法及其相關編碼模式選擇裝置，及其機器可讀取媒體	台灣	97150204	I398169	獲證	2013 0601	2028 1222			經濟部技術處
	85	資訊與通訊	數位視/音訊處理	P51970140US	移動向量之編碼模式選擇方法及其相關編碼模式選擇裝置，及其機器可讀取媒體	美國	12/473,234	8,416,855	獲證	2013 0409	2030 1001			經濟部技術處
48	86	資訊與通訊	數位視/音訊處理	P51980118US	在影像壓縮系統中使用分頻的可變長度編碼模組之硬體架構	美國	12/639,696	8,254,709	獲證	2012 0828	2031 0215			工研院
49	87	資訊與通訊	數位內容與數位學習	P51980111TW	互動式影音播放系統及方法	台灣	98140002	I382401	獲證	2013 0111	2029 1123			經濟部技術處
50	88	資訊與通訊	遠距機器對機器服務及應用	P28990011TW	定位方法與裝置	台灣	100102943	I424183	獲證	2014 0121	2031 0125			工研院
51	89	資訊與通訊	人機感知與回饋技術	P51970103TW	力回饋裝置與具有該力回饋裝置之互動系統	台灣	98107520	I369232	獲證	2012 0801	2029 0308			經濟部技術處
	90	資訊與通訊	人機感知與回饋技術	P51970103US	力回饋裝置與具有該力回饋裝置之互動系統	美國	12/481,586	8,259,066	獲證	2012 0904	2031 0126			經濟部技術處
52	91	資訊與通訊	智慧型資訊系統-處理器	P51970049US	非揮發性資料儲存系統及其方法	美國	12/466,381	8,156,278	獲證	2012 0410	2030 0708			工研院
53	92	資訊與通訊	其他	P19910002TW	電腦輔助分析專利資料方法及其系統	台灣	91124037	I220484	獲證	2004 0821	2022 1017		V	工研院
54	93	資訊與通訊	其他	P19940001TW	計畫書撰寫輔助系統及方法	台灣	94120854	I304178	獲證	2008 1211	2025 0621			工研院
55	94	機械與系統	射出成型機	P04920025TW	射出成型機之鎖模機構	台灣	92122585	I224046	獲證	2004 1121	2023 0817		V	經濟部技術處
	95	機械與系統	射出成型機	P04920025US	射出成型機之鎖模機構	美國	10/682,526	7,128,563	獲證	2006 1031	2024 1011			經濟部技術處
56	96	機械與系統	射出成型機	P04920053TW	具有壓力感測裝置之兩段式射出成型機	台灣	92136670	I263578	獲證	2006 1011	2023 1223		V	經濟部技術處
	97	機械與系統	射出成型機	P04920053US	具有壓力感測裝置之兩段式射出成型機	美國	10/795,248	7,140,860	獲證	2006 1128	2025 0325			經濟部技術處
57	98	機械與系統	射出成型機	P04930032TW	射出機之噴嘴接觸裝置	台灣	93133881	I243744	獲證	2005 1121	2024 1104		V	經濟部技術處
58	99	機械與系統	射出成型機	P04930043TW	兩段式射出成型機之排料裝置	台灣	93139758	I243743	獲證	2005 1121	2024 1220		V	經濟部技術處
59	100	機械與系統	射出成型機	P04940059TW	兩段式射出成型機之射出單元	台灣	94142735	I295618	獲證	2008 0411	2025 1204		V	經濟部技術處
	101	機械與系統	射出成型機	P04940059US	兩段式射出成型機之射出單元	美國	11/607,068	7,614,870	獲證	2009 1110	2027 1129		V	經濟部技術處
60	102	機械與系統	射出成型機	044890033US	高溫流體射出單元	美國	09/552,881	6,371,196	獲證	2002 0416	2020 0419			經濟部技術處
61	103	機械與系統	射出成型機	044890055US	射出成型機之射出及計量感測機構	美國	09/840,986	6,619,944	獲證	2003 0916	2021 1213			經濟部技術處
62	104	機械與系統	射出成型機	044900008US	電磁驅動連桿式夾模裝置	美國	09/852,795	6,540,494	獲證	2003 0401	2021 0510			經濟部技術處
63	105	機械與系統	射出成型機	044900071US	伺服驅動式夾模單元之模具保護方法	美國	10/079,418	6,641,757	獲證	2003 1104	2022 0221			經濟部技術處
64	106	機械與系統	射出成型機	044900074US	伺服驅動式射出成型機鎖模機構	美國	10/043,220	6,752,619	獲證	2004 0622	2022 0716			經濟部技術處
65	107	機械與系統	射出成型機	044910029US	射出成型機之夾模裝置	美國	10/318,170	6,893,246	獲證	2005 0517	2023 0610			經濟部技術處
	108	機械與系統	射出成型機	044910029JP	射出成型機之夾模裝置	日本	319061/2002	3790511	獲證	2006 0407	2022 1030			經濟部技術處
66	109	機械與系統	射出成型機	P04910043US	一種射出成型機之射膠螺桿力量感測裝置與方法	美國	10/435,539	7,077,637	獲證	2006 0718	2023 1130			經濟部技術處
	110	機械與系統	射出成型機	P04910043JP	一種射出成型機之射膠螺桿力量感測裝置與方法	日本	115462/2003	4036782	獲證	2007 1109	2023 0420			經濟部技術處
67	111	機械與系統	傳統機械	P28010005TW	管件的製法及其液壓成型模具	台灣	101133734	I504451	獲證	2015 1021	2032 0913			工研院
	112	機械與系統	傳統機械	P28010005CN	管件的製作方法及其液壓成型模具	中國	201210424366.2	ZL201210424366.2	獲證	2015 0715	2032 1030			工研院
	113	機械與系統	傳統機械	P28010005US	管件的製法及其液壓成型模具	美國	13/743,046	9,505,048	獲證	2016 1129	2035 0814			工研院
68	114	機械與系統	微電能產生技術	P28990004TW	振動式電磁發電機	台灣	99136915	I420788	獲證	2013 1221	2030 1027			工研院
	115	機械與系統	微電能產生技術	P28990004CN	振動式電磁發電機	中國	201010556317.5	ZL201010556317.5	獲證	2014 0507	2030 1121			工研院
69	116	機械與系統	微電能產生技術	124910007CN	多匝微線圈結構及其製造方法	中國	02121752.1	ZL02121752.1	獲證	2006 0222	2022 0528		V	經濟部技術處
70	117	機械與系統	微感測技術	P28990002TW	血液分析微系統	台灣	99135478	I432724	獲證	2014 0401	2030 1017			工研院
	118	機械與系統	微感測技術	P28990002US	血液分析微系統	美國	12/982,556	8,648,396	獲證	2014 0211	2031 0823			工研院
71	119	機械與系統	半導體切割裝置	P04910051US	分離脆性材料的旋轉對位機構	美國	10/358,207	6,892,917	獲證	2005 0517	2023 0516		V	經濟部技術處

72	120	機械與系統	自動控制技術	P04910059TW	精密氣壓缸配重裝置及其控制方法	台灣	91136774	184725	獲證	2003 0811	2022 1219		V	經濟部技術處
73	121	機械與系統	自行車	044870066US	電動自行車之傳動與感測裝置	美國	09/157,960	6,196,347	獲證	2001 0306	2018 0921			經濟部技術處
74	122	機械與系統	奈米加工技術	P51960161TWC1	加工機台	台灣	97144172	I384340	獲證	2013 0201	2028 1113			經濟部技術處
75	123	機械與系統	雷射檢測技術	P51970154TW	記錄移動平台運動軌跡的系統與方法	台灣	98113685	I408523	獲證	2013 0911	2029 0423			經濟部技術處
76	124	綠能與環境	電能轉換器	P28010002TW	被動式功因校正電路	台灣	101126638	I492502	獲證	2015 0711	2032 0723			工研院
	125	綠能與環境	電能轉換器	P28010002CN	被動式功因校正電路	中國	201210310683.1	ZL201210310683.1	獲證	2016 0914	2032 0827			工研院
	126	綠能與環境	電能轉換器	P28010002US	被動式功因校正電路	美國	13/763,222	8,995,153	獲證	2015 0331	2033 0531			工研院
77	127	綠能與環境	電能轉換器	P28990001TW	可透光式熱電能量轉換裝置	台灣	99136590	I419386	獲證	2013 1211	2030 1025			工研院
78	128	綠能與環境	電力管理	P28000010TW	通訊電力線狀態偵測方法及其系統	台灣	101103479	I480558	獲證	2015 0411	2032 0202			工研院
	129	綠能與環境	電力管理	P28000010US	通訊電力線狀態偵測方法及其系統	美國	13/451,150	9,035,751	獲證	2015 0519	2033 0810			工研院
79	130	綠能與環境	電力管理	P28000011CN	一種超級電容器模塊充放電電壓均衡裝置	中國	200510086793.4	ZL200510086793.4	獲證	2009 1007	2025 1103			工研院
80	131	生醫與醫材	其他 (含洗腎機及醫學影像)	P28000004TW	單光子電腦斷層掃描儀以及其掃描方法	台灣	100125062	I465757	獲證	2014 1221	2031 0714			工研院
	132	生醫與醫材	其他 (含洗腎機及醫學影像)	P28000004CN	單光子計算機斷層掃描儀以及其掃描方法	中國	201110315555.1	ZL201110315555.1	獲證	2015 0304	2031 1017			工研院
	133	生醫與醫材	其他 (含洗腎機及醫學影像)	P28000004US	單光子電腦斷層掃描儀以及其掃描方法	美國	13/282,204	8,664,610	獲證	2014 0304	2031 1207			工研院
81	134	生醫與醫材	生理監控	P28030003TW	攜帶型分析裝置以及系統	台灣	103110711	I551269	獲證	2016 1001	2034 0320			經濟部技術處
	135	生醫與醫材	生理監控	P28030003US	攜帶型分析裝置以及系統	美國	14/221,300	9,357,955	獲證	2016 0607	2034 0320			經濟部技術處
82	136	生醫與醫材	中草藥	P27000086TW	生產 γ-胺基丁酸的方法及利用該方法製造之食品	台灣	101102122	I542692	獲證	2016 0721	2032 0118			經濟部技術處
	137	生醫與醫材	中草藥	P27000086US	生產 γ-胺基丁酸的方法及利用該方法製造之食品	美國	13/353,516	8,673,324	獲證	2014 0318	2032 0118			經濟部技術處
83	138	材料化工與奈米	OLED 相關材料	P28000006TW	含乙烯官能基之咔唑衍生物及其用於電致發光元件之用途	台灣	100128992	I465441	獲證	2014 1221	2031 0811			工研院
	139	材料化工與奈米	OLED 相關材料	P28000006US	含乙烯官能基之咔唑衍生物及其用於電致發光元件之用途	美國	13/365,622	8,471,037	獲證	2013 0625	2032 0202			工研院
84	140	材料化工與奈米	OLED 相關材料	P28030001TW	咔唑衍生物及有機電致發光裝置	台灣	103106222	I507403	獲證	2015 1111	2034 0224			工研院
85	141	材料化工與奈米	OLED 相關材料	P28030002TW	聯苯衍生物及有機電致發光裝置	台灣	103107957	I510482	獲證	2015 1201	2034 0306			工研院
86	142	材料化工與奈米	氣體/化學檢測、校正測試方法、標準建立	P28000001TW	微粒子輸送器	台灣	100109384	I419738	獲證	2013 1221	2031 0317			工研院
	143	材料化工與奈米	氣體/化學檢測、校正測試方法、標準建立	P28000001US	微粒子輸送器	美國	13/104,016	8,603,312	獲證	2013 1210	2031 0718			工研院

(本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。)